भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2604
जिसका उत्तर 7 अगस्त, 2024 को दिया जाना है ।
16 श्रावण, 1946 (शक)

समरूप आधार पर राजकोषीय समर्थन

2604. श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के विकास के लिए योजना के अंतर्गत चिप निर्माण इकाइयों हेतु सभी प्रौद्योगिकी प्रारूपों के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत राजकोषीय समर्थन अनुमोदित किया है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): देश में सेमीकंडक्टरों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले विनिर्माण और डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित चार योजनाएँ शुरू की गई हैं:

क) '**भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना**' भारत में सिलिकॉन सीएमओएस आधारित सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ख) '**भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना**'भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए समरूप आधार पर परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ग) '**भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर्स फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना**' भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए समरूप आधार पर पूंजीगत व्यय के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

घ) **डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना:** डिजाइन अवसंरचना समर्थन के अलावा, यह योजना प्रति आवेदन 15 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा के अध्यधीन पात्र व्यय के 50% तक उत्पाद डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन और 5 वर्षों की अवधि में निवल बिक्री कारोबार के 6% से 4% के परिनियोजन संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करती है जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रु प्रति आवेदन है।

ङ) सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली के ब्राउनफील्ड फैब के रूप में आधुनिकीकरण का भी अनुमोदन किया है।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत 1,48,476 करोड़ रुपये के संचयी निवेश के साथ 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, सरकार इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण और घटक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर केंद्रित निम्नलिखित कार्यक्रमों को लागू कर रही है:

(i) इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर्स (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को दिनांक 01.04.2020 को अधिसूचित किया गया था और यह दिनांक 31.03.2024 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक संघटकों, ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण, यांत्रिकी, माइक्रो/नैनो-इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) पॉलीसिलिकॉन, एसपीवी वेफर्स और सौर सेलों, विशेष उप-असेंबली और उपर्युक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। दिनांक 30.06.2024 तक, स्पेक्स योजना के तहत 8,803.14 करोड़ रुपये का वृद्धिशील निवेश किया गया था। इससे 30 जून, 2024 तक 18,083.55 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है।

(ii) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना**:** घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित मोबाइल फोन मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने के लिए, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) दिनांक 01.04.2020 को अधिसूचित की गई थी। यह योजना 5 साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को भारत में निर्मित और लक्ष्य खंडों जैसे मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के तहत शामिल वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष की तुलना में) पर 3% से 6% तक का प्रोत्साहन देती है। 30 जून, 2024 तक, पीएलआई योजना के तहत 8,390 करोड़ रुपये का वृद्धिशील निवेश किया गया था। इससे 30 जून, 2024 तक 5,14,960 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है।

****